

证券代码：603893

证券简称：瑞芯微

瑞芯微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会)

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位	投资者提问
时间	2024 年 5 月 16 日
地点	公司通过上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com/) 采用视频和网络文字互动的方式召开“2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会”。
接待人员	副总经理兼 CFO：王海闽先生 副总裁：李诗勤先生 独立董事：乔政先生 副总经理兼董事会秘书：林玉秋女士
投资者关系 活动主要内 容介绍	<p>公司主要就投资者提出的相关问题进行互动和沟通：</p> <p>1、看到公司今年一季度业绩非常好，想问下二季度订单情况如何？</p> <p>回答：一季度市场需求有所复苏，企业景气度回暖，同时公司长期深耕的 AIoT 各产品线逐步发力，在汽车电子，工业应用，机器视觉等领域大幅提升。由于公司产品应用在 AIoT 百行百业中，不同的应用领域情况有所不同，二季度估计整体延续一季度趋势。目前公司仍在紧密关注市场变化，争取抓住更多机会，在 AIoT 的百行百业持续突破。</p> <p>2、目前国家正在大力推进大规模设备更新和消费品以旧换新，上周国家发展改革委主任郑栅洁还主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新第二次专题座谈会。这些政策是否对贵公司发展有积极影响？</p> <p>回答：大规模设备更新政策注重产业升级改造、主要作用于企业投资端，消费品以旧换新政策注重促进消费、主要作用于消费者需求端，二者结合将共同拉动市场需求，推动国民经济向好发展。公司作为国内 AIoT SoC 芯片的领先者，在 AIoT 核心技术、产品应用、市场布局、客户资源方面积累深厚，致力于为下游提供多算力的 AIoT SoC 芯片平台，赋能百行百业的数字化、智能化升级。相关政策的大力推行可以拉动公司下游汽车电子、机</p>

器视觉、工业应用、教育办公、商业金融、智能家居、消费电子等多领域的产品需求，助力公司业务快速发展。

3、公司今年的研发投入规划是什么样的，有哪些重点研发项目及领域？

回答：公司长期保持高强度的研发投入以打造产品与技术持续领先的布局，连续 10 年保持研发投入占营收比重约 20%。今年将继续以边缘侧、端侧的 AIoT 芯片为重点，推进 AI 协处理器、中高端视觉处理器、新一代经济型视觉处理器、新款通用 SoC 处理器、音频功放芯片等多款新产品的研发，并持续打磨神经网络处理、影像视觉处理、高清视频编解码、视频后处理、智能语音、光电一体化等核心 IP 以及 AI 视觉、AI 音频等核心算法，着力发展汽车电子、工业及机器人应用、音频、AI 平板等产品应用方向，不断巩固在国内 AIoT SoC 芯片供应商的领先地位，为客户提供更好的 AIoT 芯片产品和解决方案。

4、最新芯片什么时间开卖？

回答：公司今年推出了一系列新产品，例如新一代中高端 AIoT 处理器 RK3576、AI 音频处理器 RK2118、新一代经济型智能视觉处理器 RV1103B/C、接口转换芯片 RK628F、无线连接芯片 RK960、音频 CODEC 芯片 RK730 等，这些芯片将从 Q2 开始陆续量产。

其中，新一代中高端 AIoT 处理器 RK3576 采用先进制程设计，搭载公司自研的 6TOPs 算力的最新一代 NPU，支持 Transformer 模型架构相关算子，人工智能计算效率显著提升，可以支持各类 AI 算法高效运行，在同档次产品中具有良好的竞争力，可广泛应用于汽车智能座舱、平板电脑、电子书、交互大屏、投影仪、网络存储设备、云电脑、机器视觉、工业应用等市场的主流产品。

5、公司目前有没有关于拓展算力芯片业务的战略规划？

回答：公司主要产品广泛应用于边缘侧及端侧的 AIoT 领域，面对算力需求快速增长与 SoC 系统级芯片迭代升级周期的矛盾，在算力芯片上确实有我们的规划和思考。截至目前，能够为客户提供从 0.5Tops 到 6Tops 的不同算力芯片，满足不同领域客户、不同层次的算力需求。此外，专用 AI 算力芯片的规划，可以通过与 RK3588、RK3576 等 AIoT 芯片平台配合，可以进一步满足边缘侧、端侧设备的 AI 算力升级需求，助力人工智能技术在各行各业的落地应用。

6、公司今年在汽车电子领域有什么新进展？

回答：公司在汽车电子领域布局了智能座舱、仪表盘与中控、车载摄像头、车载音频、视频传输等前装五大方向及后装各类产品。其中在智能座舱领域，目前已有多款搭载 RK3588M 的车型量产，并且与头部车厂的更多后续车型正在合作开发中，同时 RK3576 也正在进行车规验证及客户导入；在车载音频领域，公司正积极推进新款音频芯片 RK2118 在客户项目量产；在仪表盘/车机中控、行车记录仪、MDVR、AVM、流媒体后视镜等产品上，公司产品已落地众多车型，还在持续导入更多新项目。公司将继续发挥 AIoT 长期积累的场景应用和技术优势，加大在汽车电子领域的投入，推进汽车电子各个产品线全面发展。

7、贵公司老是说车企合作，但是为什么没有公告和哪些车企？

回答：公司依托 AIoT 的技术和产品优势，已与多家国内头部汽车厂商达成乘用车、商用车上多产品线合作量产。其中 RK3588M 于 2023 年开始已有数个车型量产，并且有更多后续车型正在合作开发、即将量产，例如多款新车型已经在北京车展上亮相。考虑到和终端客户的保密协议，暂未披露量产车型等具体情况，后续相关宣传可关注公司微信公众号。

8、公司在机器视觉都有哪些产品布局和应用？

回答：公司在机器视觉领域拥有 RK3588、RK3576、RV1109/RV1126、RV1106/RV1103、RV1103B/C 等一系列不同性能层次的产品及解决方案。凭借齐全的产品阵列、优异的图像效果和智能化的技术应用，公司产品正在获得越来越多客户的认可和选用，市场份额稳步提升。目前公司产品已广泛应用于家庭、商业、办公、行业应用等各个机器视觉领域，覆盖各类 IPC、智能门锁、智能家居、智能支付、词典笔、机器人、扫地机、车载摄像头、工业相机、智能巡检设备等各类智能终端设备。

9、公司所处的图像处理 SoC 领域市场竞争激烈，请问目前的竞争格局如何？价格是否触底？AI SoC 市场渗透率如何？公司在该领域有何优势？

回答：公司在图像处理 SoC 领域有较多的布局，用齐全的产品阵列赋能机器视觉领域的众多场景，包括 RV 系列平台 RV1109/RV1126/RV1106/RV1103 和 RK3576、RK3588 等。公司充分利用在影像视觉技术、视频编码技术、尤其是人工智能技术上的长期积累，陆续推出有竞争力的芯片平台，技术上快速迭代；在 AI 算法上加大投入，推出面向很多图像视觉相关应用场景的 AI 算法，比如超分、数据结构化等；在解

决方案上，尤其针对低功耗应用的产品或场景，公司利用技术的创新实现 AOV、Preroll、快速启动等功能，以较高的性价比赋能客户在机器视觉领域的智能升级。公司产品正获得越来越多客户的认可，市场份额稳步提升，目前公司产品广泛应用于家庭、商业、办公、工业、电力等各个机器视觉领域，覆盖各类 IPC、智能门锁、智能家居、智能支付、词典笔、扫地机、车载摄像头、工业相机、智能巡检等百行百业的智能终端设备。

10、请问公司提到要重点发展音频产品线，目前主要有哪些布局和规划？

回答：公司依托多年来在音频领域的技术积累，布局了包括 NANO 系列、RK2108、RK3308、RK3562 等多款芯片，并在软件算法层面整合了声学处理、多麦阵列、AI 降噪、离线关键词识别等音频算法，广泛应用于智能音箱、音频播放器、会议拾音设备、专业拾音设备等领域，通过了腾讯、微软、Zoom 等主流会议系统软件的认证，覆盖了众多行业头部客户。2024 年，公司在开发者大会上新发布了多核高性能 Audio DSP RK2118，主要针对车载音频、Soundbar、通用音频等应用设计，后续还将进一步推出音频 Codec，音频功放等模数混合芯片，进一步拓展公司音频市场产品线，为公司在音频市场的快速扩张打下良好基础。

11、请问公司怎么看现在边端侧 AI 产品的新机会？

回答：我们看到近来业内出现很多企业通过各种各样智能终端硬件来探索 AI 大模型在端侧应用场景的落地。这类新型智能硬件通常会在端侧配置一定性能的算力，可以接入云端的 AI 大模型来满足智能化交互需求。当前已有多家客户基于瑞芯微主控芯片推出接入 AI 大模型的新硬件，例如 AI 学习机、词典笔、AI 摄像头等产品。此外，公司的 RK3588、RK3576 等产品也能够支持端侧模型的部署。未来公司会继续升级人工智能相关技术，不断提升对 AI 大模型的支持效率，持续积极与产业链合作伙伴共同挖掘新硬件的市场机会。

12、目前 AI 大模型在瑞芯微平台的落地情况如何？

回答：随着生成式 AI 的快速发展，算力会根据应用场景在云、边、端之间形成合理分布，并推动模型的小型化、专业化，逐步发展出各种适合特定场景的端侧或边缘侧应用。公司产品应用方向主要为端侧、边缘侧的 AIoT，高性能处理器如 RK3588、RK3576 带有 6TOPs NPU 处理单元，可以高效支持主流模型架构，针对端侧主流的 2B 参数数量级别的模型能达到每

秒 10 token 以上，满足小模型在边、端侧部署的需求，赋能各种 AIoT 场景下端侧和边缘计算侧的产品应用。我们在 2024 年第八届瑞芯微开发者大会展出了基于端侧模型实现的图文搜索及特定目标智能搜索、基于图片对话式提取信息以及离线语音识别、翻译、总结、问答等功能，有效解决了不同 AIoT 场景的痛点，改善产品使用体验。

13、是否能详细介绍一下公司的存货情况？当前公司存货过高，有消息说公司存在向下游公司压货的情况？

回答：截至 2024 年 3 月 31 日，公司存货为 11.5 亿元，库存水位已从 2023 年 6 月底的 15.1 亿元连续 3 个季度下降，逐步回到合理的状态。公司主要产品为较先进工艺制程，设计复杂度高、生产周期长，而且客户从导入到量产也需要较长研发周期，叠加当前复杂多变的国际形势，公司采用战略性备货、滚动备货相结合的方式以保障客户产品供应链的安全。一季度市场需求有所复苏，企业景气度回暖，下游客户库存回归正常。我们将进一步优化库存结构，持续改善经营管理，以保持公司在行业可持续的竞争优势。

14、请问今年公司分红派息的具体安排，预计什么时间发放股息？

回答：公司长期坚持通过现金分红提高投资者回报水平，2020 年上市以来已累计分红 8.12 亿元，累计现金分红比例 57%。2023 年公司计划现金分红每 10 股 2 元，预计分红总金额 8,362 万元，现金分红比例 62%。该分红预案将于年度股东大会审议通过后 2 个月内完成利润分配，具体发放时间敬请关注公司年度股东大会召开安排及后续披露的权益分派实施公告。

15、请问公司大股东在公司路演的前 2 天发布减持公告，这个公告的选择时间是上交所硬性规定的么？如果不是，为什么不放到路演结束以后在公告呢？

回答：公司分别于 2024 年 4 月 15 日、4 月 26 日披露 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，并在披露后与上证路演中心排队预约选定本次业绩说明会召开时间。大股东减持受多方面因素的限制，如窗口期等，两者没有必然联系，没有特意安排调整。

16、问下前 10 大股东持股比例都是减少的，是公司经营出现什么问题了导致都不看好吗？

回答：公司前 10 大股东大部分都是 IPO 前引进的，包括 IPO 前进入的行业投资机构、员工持股平台等，上市解禁后陆续减持是他们正常操作方

	<p>式。目前公司经营情况良好，随着市场需求复苏、行业周期见底回升，公司有信心在未来实现突破与成长。</p> <p>17、请问最近第二大股东在开业绩会前发布减持，是公司未来前景不好嘛，为什么股价下落速度这么快？</p> <p>回答：公司股票价格由宏观、行业以及企业等多方面因素的综合驱动，而过去一段时间半导体行业股票价格波动受到行业周期与近期资本市场波动的系统性风险影响尤甚。公司营收以及业务拓展等基本面运营平稳，相较于同行业其他可比公司，公司股票价格走势以及估值等市场指标未出现显著特质性的风险波动。</p>
附件清单	无
时间	2023年5月17日
备注	交流过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，不存在透漏任何未公开重大信息的情形。